

三维X射线晶圆级封装计量系统

3D X-Ray Metrology System for WLP

MXCL-300



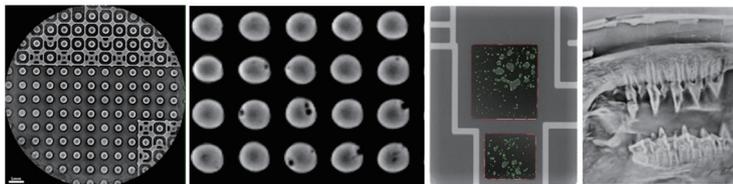
主要技术与性能指标

- 最高电压：160 kV
- 最大靶功率：50 W
- 最高 JIMA 分辨率：1 μm
- 具有 2D、2.5D 和 3D 成像功能，可对 TSV、晶圆凸块、MEMS、SIP 封装缺陷、PCBA 等进行高精度三维 X 射线计量
- 最大样本尺寸：300 mm \times 300 mm，可检测 12 寸晶圆

主要应用

电路板、芯片、板状化石等板状物体的二维 / 三维无损检测

代表性应用成果



多层 PCB、BGA 焊球、胶层气孔、化石等成像结果

主要用户单位	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、嘉兴斯达半导体股份有限公司、通富微电子股份有限公司
研制单位	中国科学院高能物理研究所
联系方式	郭静 010-88235521, 13466719776 guojing@ihep.ac.cn